**PR与innovus脚本调试方面：**

1.nothing【刘婧恬】

2.准备近期后端组拟招录工程师面试【杨彬彬】

3.逻辑综合脚本比对及综合环境优化【杨彬彬】

4.前端交付后端文件列表初稿拟定【杨彬彬】

5.RTL与综合后网表LEC 比对 debug【杨彬彬】

6.组内周例会会议纪要撰写【杨彬彬】

7.撰写Redhawk功耗分析流程文档初版【李峥】

8.研究htree脚本，通过改变插入的inverter、net数量等方法尝试在β中使用htree来做CTS【胡梦恬】

9.【胡梦恬】

10.熟悉逻辑综合的流程以及脚本环境【卜苗苗】

11.在PT环境下进行时序的优化，并在innovus中修复设计时序（hold从-s修复到-s）【卜苗苗】

12.对PT环境下优化时序命令进行总结【卜苗苗】

**封装工作方面：**

1.沟通交互塑封芯片成品首批产出时间和产量，目前首批成品芯片时间约为，产量【王贺】

2.与通交互机台测试与封装设计过程中的问题【王贺】

3.定版封装标识设计，确认封装标识编码包含的信息，如日期、封装类型等【王贺】

4.参与慢速外设硅后测试用例调试【王贺】

5.封装、DFT测试相关情况跟进【桂羽】

6.专利撰写【桂羽】

7.根据PR手册熟悉后端物理设计布局布线环境配置和搭建【邢玉婷】

8.与封装与测试进度同步会【邢玉婷】

9.参与芯片入门培训课程【邢玉婷】

10.时序分析案例培训【邢玉婷】

**PR与innovus脚本调试方面：**

1.继续PR流程，优化route时序违例问题【刘婧恬】

2.整理calibre相关报错【刘婧恬】

3.【杨彬彬】

4.继续推进设计时序瓶颈debug【杨彬彬】

5.完成内部评测版simd码逻辑综合评估工作（待前端更新RTL代码）【杨彬彬】

6.使用redhawk报出β的平均功耗。【李峥】

7.继续完善Redhawk功耗分析流程文档，增加瞬时功耗部分【李峥】

8.继续研究htree脚本，并尝试在β中使用htree来做CTS【李峥】

9.继续研究htree脚本，通过改变插入的inverter、net数量等方法尝试在β中使用htree来做CTS【胡梦恬】

10.配置redhawk环境，使用redhawk报出β的平均功耗【胡梦恬】

11.整理htree脚本形成文档【胡梦恬】

12.前端RTL代码过来后进行尝试跑通逻辑综合【卜苗苗】

13.PT环境下继续优化setup和hold【卜苗苗】

**封装工作方面：**

1.沟通交互调测试夹具使用问题【王贺】

2.熟悉学习PR环境和流程【王贺】

3.封装、DFT测试相关情况跟进【桂羽】

4.专利交底书迭代更新【桂羽】

5.根据PR手册熟悉后端物理设计布局布线环境配置和搭建【邢玉婷】

6.和FT对接塑封的生产与装配【邢玉婷】

7.调研多芯粒封装技术资料【邢玉婷】

8.芯片入门培训课程【邢玉婷】